

全“芯”赋能汽车智能化，四维图新旗下杰发科技黑科技产品重磅来袭！

开启多核新纪元，构建自主芯生态。四维图新旗下杰发科技重磅MCU新品AC7870即将亮相2025慕尼黑上海电子展，敬请期待。

2025

慕尼黑上海电子展

随着智能网联汽车的快速发展，汽车电子芯片正成为推动行业变革的核心驱动力。智能座舱、智能驾驶、电气化等趋势对芯片性能、集成度及可靠性提出了更高要求。对此，四维图新旗下杰发科技携最新芯片产品及创新场景应用方案，诚邀您莅临2025慕尼黑上海电子展·杰发科技展台，共探未来驾驶，芯动智能出行！

产品展示

SOC

产品及座舱应用

单行合一SoC、智能座舱SoC、车联用SoC、车载信息娱乐系统SoC等核心产品矩阵，以敏捷性的技术方案赋能智能汽车，搭载下一代自动驾驶与智能座舱的应用升级，并灵活拓展两轮车应用，满足多样化出行需求。

MCU

产品及场景应用

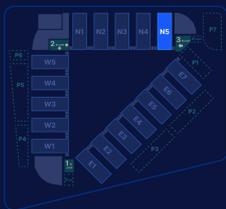
基于M0+、M3、M4F、R52内核的多核车规级MCU，以高可靠、高安全、高性价比等特征，全面赋能汽车电子系统智能化升级，并针对车联手机无线充电、智能车灯控制等多种细分场景打造系列化解决方案，满足丰富应用需求。

关于杰发科技

杰发科技成立于2013年，是四维图新全资子公司，专注于汽车电子芯片及相关系统的研发与设计。当前，杰发科技已形成SoC与MCU双轮驱动产品矩阵，累计出货量超3亿颗，其中SoC芯片累计出货近9000万颗，MCU芯片累计出货量超7000万颗，是车规级芯片的行业领先企业。当前，公司产品已进入国内95%以上整车厂供应链，并与国内外主流Tier 1供应商深度合作。此外，杰发科技持有国内外专利3300余件，并通过ISO 26262、AEC-Q100等权威认证，连续多年获评“中国芯”优秀产品奖。

发布会时间

- 4月15日 14:30-14:45
- 上海国际博览中心
- 展位号：N5.244



扫码预约

自主芯生态
智领新出行

NV/INCO autochips
四维图新 杰发科技

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/224403.html>